

(12) International Application Status Report

Received at International Bureau: 03 October 2018 (03.10.2018)

Information valid as of: 24 December 2018 (24.12.2018)

Report generated on: 16 July 2019 (16.07.2019)

(10) Publication number:

WO2019/065526

(43) Publication date:

04 April 2019 (04.04.2019)

(26) Publication language:

Japanese (JA)

(21) Application Number:

PCT/JP2018/035139

(22) Filing Date:

21 September 2018 (21.09.2018)

(25) Filing language:

Japanese (JA)

(31) Priority number(s):

2017-184854 (JP)

(31) Priority date(s):

26 September 2017 (26.09.2017)

(31) Priority status:

Priority document received (in compliance with PCT Rule 17.1)

(51) International Patent Classification:

H01L 21/027 (2006.01); *B29C 59/02* (2006.01); *C08F 2/48* (2006.01); *C08F 20/20* (2006.01)

(71) Applicant(s):

FUJIFILM CORPORATION [JP/JP]; 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1068620 (JP) *(for all designated states)*

(72) Inventor(s):

SHIMOJU Naoya; c/o FUJIFILM CORPORATION, 4000 Kawashiri, Yoshida-cho, Haibara-gun, Shizuoka 4210396 (JP)

GOTO Yuichiro; c/o FUJIFILM CORPORATION, 4000 Kawashiri, Yoshida-cho, Haibara-gun, Shizuoka 4210396 (JP)

(74) Agent(s):

SIKS & CO.; 8th Floor, Kyobashi-Nisshoku Bldg., 8-7, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040031 (JP)

(54) Title (EN): COMPOSITION FOR FORMING UNDERLAYER FILM FOR IMPRINTING, KIT, CURABLE COMPOSITION FOR IMPRINTING, LAMINATED BODY, METHOD FOR MANUFACTURING LAMINATED BODY, METHOD FOR MANUFACTURING CURED PRODUCT PATTERN, AND METHOD FOR MANUFACTURING CIRCUIT SUBSTRATE

(54) Title (FR): COMPOSITION POUR LA FORMATION D'UN FILM DE SOUS-COUCHE POUR IMPRESSION, KIT, COMPOSITION DURCISSABLE POUR IMPRESSION, CORPS STRATIFIÉ, PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN CORPS STRATIFIÉ, PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN MOTIF DE PRODUIT DURCI ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN SUBSTRAT DE CIRCUIT

(54) Title (JA): インプリント用下層膜形成用組成物、キット、インプリント用硬化性組成物、積層体、積層体の製造方法、硬化物パターンの製造方法および回路基板の製造方法

(57) Abstract:

(EN): The present invention provides: a composition for forming an underlayer film for imprinting, the composition being capable of forming a stable film which has uniform thickness and to which a curable composition for imprinting shows excellent wettability; a kit; a curable composition for imprinting; a laminated body; a method for manufacturing a laminated body; a method for manufacturing a cured product pattern, and a method for manufacturing a circuit substrate. The composition for forming an underlayer film for imprinting comprises a solvent and a multifunctional (meth)acrylate that includes at least one of an aromatic ring and an aromatic heterocyclic ring, the multifunctional (meth)acrylate having a viscosity at 23°C of 11-600 mPa·s and a molecular weight of 200 or more.

(FR): La présente invention concerne : une composition pour la formation d'un film de sous-couche pour impression, la composition pouvant former un film stable qui présente une épaisseur uniforme et auquel une composition durcissable pour impression confère une excellente mouillabilité ; un kit ; une composition durcissable pour impression ; un corps stratifié ; un procédé de fabrication d'un corps stratifié ; un procédé de fabrication d'un motif de produit durci et un procédé de fabrication d'un substrat de circuit. La composition pour la formation d'un film de sous-couche pour impression comprend un solvant et un (méth)acrylate multifonctionnel qui comprend au moins l'un parmi un noyau aromatique et un noyau hétérocyclique aromatique, le (méth)acrylate multifonctionnel présentant une viscosité à 23 °C égale à 11 à 600 mPa·s et un poids moléculaire supérieur ou égal à 200.

(JA): 形成された膜の厚さの均一性とインプリント用硬化性組成物の濡れ性に優れ、形成される膜が安定であるインプリント用下層膜形成用組成物、キット、インプリント用硬化性組成物、積層体、積層体の製造方法、硬化物パターンの製造方法および回路基板の製造方法を提供する。芳香環および芳香族複素環の少なくとも1種を含む多官能(メタ)アクリレートと溶剤を含み、多官能(メタ)アクリレートは、23°Cにおける粘度が11~600 mPa·sであり、分子量が200以上である、インプリント用下層膜形成用組成物。

International search report:

Received at International Bureau: 24 December 2018 (24.12.2018) [JP]

International Report on Patentability (IPRP) Chapter II of the PCT:

Not available

(81) Designated States:

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

European Patent Office (EPO) : AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR

African Intellectual Property Organization (OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) : BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM